

無鉛焊接信息

- 所有 CamSemi 封裝均為無鉛
- 符合 JEDEC 和 RoHS 標準
- 符合 1 級潮濕敏感度

概述

為了符合 CamSemi 推動更加清潔的環境以及控制電子元件中使用鉛的最新立法，CamSemi 的所有產品都採用了無鉛封裝。

無鉛焊接比標準含鉛焊接需要更高的最高溫度，所以建議遵照下列詳盡指南。

本文概述了焊接 CamSemi 產品的基本推薦標準，而且符合 JEDEC 推薦標準 (JSTD020C) 和有害物質限制使用 (RoHS) 指令 (2002/95/EC)。

一般資訊

SMD 指南：

CamSemi 當前提供兩種表面貼裝封裝類型。SOT23-6 和 SOP-8 的厚度均為 1.6 mm，低於 350 mm³ (管體體積)，可以將它們放在 260°C 最大回流焊溫度設備中 (參考：JSTD 020C)。

SOT23 和 SOP-8 過錫爐溫度曲線資訊：

下圖 (圖 1) 和表 (在另一面) 詳細顯示了所有 CamSemi 產品合格的焊接溫度曲線。不過，具體的電路板/應用要求可能使這個溫度曲線有所偏離，它僅可用作一個指南。請注意：CamSemi 器件採用了高純錫引線精加工工藝，不應該採用為含鉛精加工開發的焊接溫度曲線。

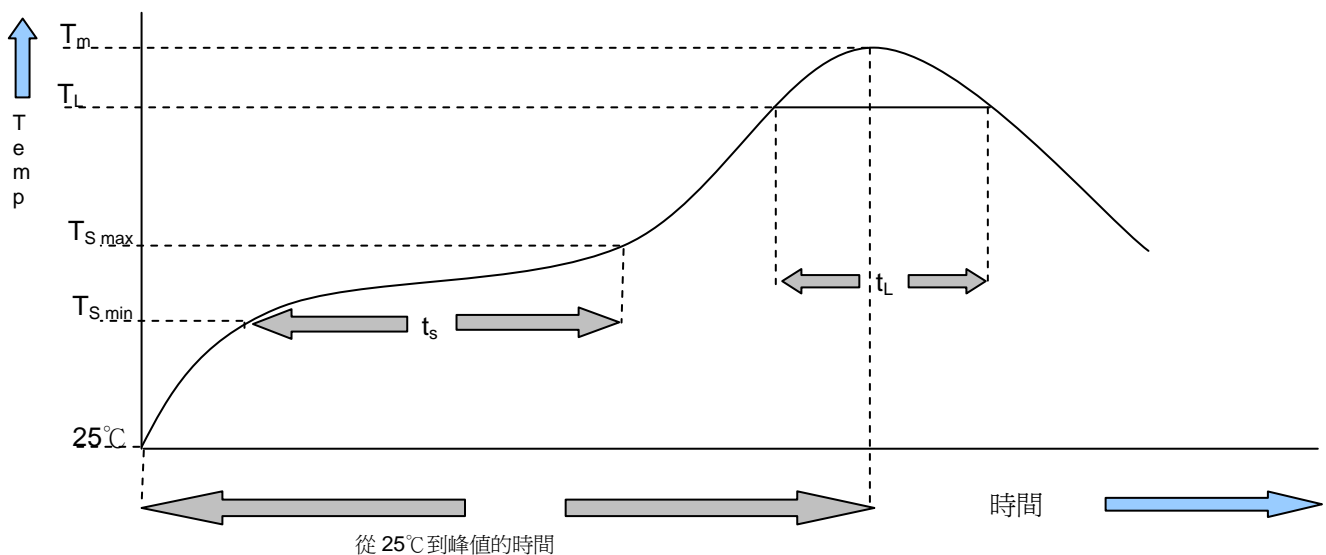
SOT23 和 SOP-8 焊接相關資訊：

英商康橋半導體的產品能夠使用波焊或是其它浸焊技術進行組裝。進行此一程序的典型方式為在 260°C 焊接槽中放置 5 ± 1 秒左右。

潮濕敏感度：

所有產品的潮濕敏感度均為 1 級，這就意味著在典型 (≤30°C/85) 的 RH 條件下，車間壽命時間是無限的。

圖 1：為焊接推薦的回流焊溫度曲線



溫度曲線	SOT23 (無鉛) / SOP-8 (無鉛)	PDIP (無鉛) — 通孔
平均升高速度 (Ts 最大 Tm)	每秒最高 3°C	不詳
峰值溫度 (Tm)	260°C	260°C 不超過 10 (+2) 秒
下降斜率	每秒 6°C	不詳
從 25°C 到 Tm 的總時間	8 分鐘 (最多)	不詳
5°C Tm 內的時間	20-40 秒	不詳
217°C 以上的時間 (tL)	60-180 秒	不詳
預熱		
最低溫度 (Ts 最低)	150°C	不詳
最高溫度 (Ts 最高)	200°C	
時間 (ts)	60-180 秒	

有害物質限制使用考慮因素

所有 CamSemi 產品均已進行了獨立測試，以確保符合最新的 RoHS 立法。欲瞭解更多資訊，請訪問 www.camsemi.com/corporate/quality.htm

瞭解更多資訊

有任何有關回流焊規範的進一步問題請聯繫 CamSemi 的品質部門。關於細節和我們的管道合作夥伴及未來產品、技術或公司最新動態的資訊，請訪問 www.camsemi.com。

聯絡資訊

英國總公司

CamSemi
St Andrews House
St Andrews Road
Cambridge, CB4 1DL
United Kingdom

Tel: +44 1223 446450

台北分公司

CamSemi
6F, No.58, Zhouzi St.,
Neihu District,
Taipei City 114,
Taiwan (R.O.C.)

Tel: +886 2 8178 1010

中國辦事處

Room 201, 2F
Shenzhen Academy of
Aerospace Technology,
Tower B, 10th Kejinan Rd.
Nanshan District,
Shenzhen, China 518057

Tel: +86 755 8611 7778

韓國分公司

No. 808 KOFOMO Tower
16-2 Sunae-Dong, Bundang-GU
Sungnam-Si
Kyunggi-Do
463-825,
South Korea

Tel: +82 31 711 1415